

## Sun Blade™ X6275 サーバ・モジュール

世界最高水準の密度を誇るハイパフォーマンス・ブレード・サーバ



### Highlights

- 1 ブレードに、2基の高性能インテル Xeon プロセッサ 5500 番台を搭載したノードを、2 ノード実装。ラックあたり最大 96 ノードを集約可能
- ノードあたり 12 の DDR3 DIMM スロットを備え、最大 96GB<sup>\*1</sup> のメモリを構成可能
- ノードあたり 1 基の 4x QDR Infiniband HCA をオンボードで提供
- SATA 接続の Sun™ Flash モジュール用スロットを装備。ファイルシステムへのアクセス性能の高速化や、省電力の OS 起動用デバイスとして利用可能
- オペレーティングシステムとして Linux を実行可能で、柔軟な選択肢を提供
- パフォーマンスやスケーラビリティに妥協することなく、優れた効率性と保守性を提供するモジュール設計
- Sun xVM Ops Center またはサードパーティ製ソフトウェアによる容易な管理が可能

1 ブレードに 2 ノードの 2 ソケット・サーバを実装した Sun Blade X6275 サーバ・モジュールは、ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) に最適な、かつてない演算資源の集約を可能にします。さらに、40Gb/秒 (双方向) の帯域幅を持つ低遅延の QDR Infiniband HCA をオンボードに標準搭載し、I/O ボトルネックを抑制します。Sun Constellation System の一部として導入すれば Sun Blade 6048 のシャーシ (一般的な 42U の 19inch ラックに相当) に 96 ノードを搭載でき、設置面積と管理、そして保守コストの削減も期待できます。インテル QuickPath インターコネクト/インテル ターボ・ブースト・テクノロジー/インテル ハイパースレディング・テクノロジーといった特長を持つインテル Xeon プロセッサ 5500 番台は、かつてない高性能と省エネルギー性を実現し、1 台の Sun Blade 6048 シャーシで 9TFLOPS を超える演算性能を提供できます。

Sun Blade X6275 サーバ・モジュールも、既存のすべての Sun Blade プラットフォームと同様に、独立した I/O サブシステムを採用しています。サーバ・モジュールと I/O はホットプラグが可能で、個別に追加や交換が行えます。Sun Blade X6275 サーバ・モジュールには 2 つのノードが統合されていますが、それぞれのノードに標準で管理プロセッサを装備しているため各ノードを個別のラックマウント・サーバのように管理できます。また、Sun

Blade X6275 サーバ・モジュールを使用すればシステムの複雑さを増すことなくコンピューティング・リソースを拡張できます。このサーバ・モジュールを Sun が提供する多彩なソフトウェア/ストレージ/サービスと組み合わせることで、システムの複雑化を抑えながらコスト削減が期待でき、きわめて負荷の大きいアプリケーションやシミュレーションでより短期間に成果を上げることが可能になります。

\*1. 将来提供予定の 8GB DDR3 DIMM を使用した場合。

## Sun Blade™ X6275 Server Module

## Sun Blade X6275 Server Module 仕様 (1 ノードあたり)

プロセッサ	プロセッサ種別 モデル・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ-5500 番台 インテル Xeon プロセッサ- X5570 (4 コア 2.93GHz 8MB キャッシュ 95W 6.4GT/s QPI DDR3-1333) インテル Xeon プロセッサ- X5560 (4 コア 2.80GHz 8MB キャッシュ 95W 6.4GT/s QPI DDR3-1333) インテル Xeon プロセッサ- E5540 (4 コア 2.53GHz 8MB キャッシュ 80W 5.86GT/s QPI DDR3-1066) インテル Xeon プロセッサ- E5520 (4 コア 2.26GHz 8MB キャッシュ 80W 5.86GT/s QPI DDR3-1066) インテル Xeon プロセッサ- L5520 (4 コア 2.26GHz 8MB キャッシュ 60W 5.86GT/s QPI DDR3-1066)
	搭載可能最大プロセッサ数	2
チップセット		インテル 5500 チップセット
メモリ	メイン・メモリ	DDR3-1333 または DDR3-1066 レジスタ付 (registered) DIMM ECC / 拡張 ECC 機能
	スロット数	合計 12 (CPU ソケット毎に 6)
	標準容量	2GB (2GB × 1) ~ 48GB (4GB × 12)
	増設単位	2GB, 4GB
内蔵インタフェース	フラッシュ・モジュール(オプション)	1 (SATA) 接続
	USB	USB 2.0 × 1
管理機能	ILOM	オンボードの ILOM サービス・プロセッサによる DMTF スタイルの CLI / SSH 2.0, HTTPS, RADIUS, LDAP, Microsoft Active Directory のサポート/ブラウザベースの GUI / IPMI 2.0: SNMP v1, v2c, v3 / KVM の (キーボード/ビデオ/マウス/ストレージ) リモート管理 / リモート・メディア機能 (フロッピー/DVD/CD など)
ミッドプレーンに接続される I/O 種別		PCI-Express Gen2(x8) × 1 (EM に接続) / QDR IB ポート × 1 (NEM に接続) / 10/100/1000BASE-T ポート × 1 (NEM に接続) / 管理用 10/100BASE-T ポート × 1 (CMM に接続)
フロントパネルでアクセス可能な I/O 種別 (UCP ドングル・ケーブルが必要)		VGA グラフィックス・ポート (DB15) × 1 / 管理用シリアル・ポート × 1 (RJ45) / USB 2.0 ポート (キーボード/マウス/ストレージ用) × 2
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1		記載対象外
寸法 (突起物含まず) と重量 幅/奥行/高さ/最大重量		4.4cm / 51.2cm / 32.7cm / 7.71kg
オペレーティングシステム		CentOS 5.3, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 10

\*1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

最新の情報については、<http://jp.sun.com/x6275/> をご参照ください。  
本製品の保証内容の詳細については、<http://jp.sun.com/service/support/warranty/> をご覧ください。



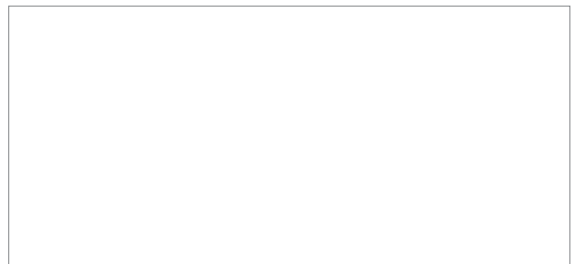
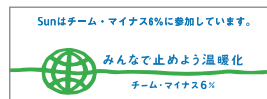
## サン・マイクロシステムズ株式会社

本社	〒158-8633	東京都世田谷区用賀 4-10-1	SBS タワー	電話 (03) 5717-5000 (代)
山王 オフィス	〒100-6160	東京都千代田区永田町 2-11-1	山王パークタワー 12F	電話 (03) 4232-2400 (代)
神宮前 オフィス	〒150-0001	東京都渋谷区神宮前 2-4-11		電話 (03) 5843-1100 (代)
名古屋 オフィス	〒460-0008	名古屋市中区栄 3-7-22	栄 928 ビル 6F	電話 (052) 264-4611 (代)
大阪 支社	〒541-0052	大阪府中央区安土町 1-8-15	野村不動産大阪ビル 5F	電話 (06) 6265-5700 (代)
九州 オフィス	〒814-0001	福岡市早良区百道浜 2-1-22	福岡 SRP センタービル 9F 901-A	電話 (092) 834-0101 (代)
つくば 営業所	〒305-0032	茨城県つくば市竹園 1-6-1	つくば三井ビルディング 11F	電話 (0298) 51-2210 (代)
豊田 営業所	〒471-0833	愛知県豊田市山之手 5-73-1	山之手ビル 7F	電話 (0565) 25-5701 (代)
ホームページ	<a href="http://jp.sun.com/">http://jp.sun.com/</a>			

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 USA Phone 1-650-960-1300 or 1-800-555-9SUN Web sun.com

© 2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. ● Sun, Sun Microsystems, Sun のロゴマーク, Solaris, Sun Blade は、米国 Sun Microsystems, Inc. の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。● Intel, インテル, Intel ロゴ, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●本文中に記載の各社の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

資料の内容は、お断りなしに変更することもありますのでご了承ください。



本誌は植林・森林認証取得木材  
および古紙パルプ配合による再生紙  
と「大豆インキ」を使用しています。



Sun Blade X6275-00 0409/2P3K SunWIN #555882 Lit. #SYDS14857JP-0 4/09